

平成28年6月15日判決言渡

平成27年(ネ)第10120号 損害賠償等請求控訴事件

(原審 大阪地方裁判所平成26年(ワ)第1860号)

口頭弁論終結日 平成28年4月13日

判 決

控訴人(一審原告) T O W A 株 式 会 社

訴訟代理人弁護士 小 松 陽 一 郎

森 本 純

中 原 明 子

訴訟復代理人弁護士 原 悠 介

被控訴人(一審被告) アサヒ・エンジニアリング株式会社

訴訟代理人弁護士 深 井 俊 至

磯 田 直 也

主 文

- 1 本件控訴を棄却する。
- 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

用語の略称及び略称の意味は、本判決で付するもののほか、原判決に従い、原判決で付された略称に「原告」とあるのを「控訴人」に、「被告」とあるのを「被控訴人」と、適宜読み替える。

第1 控訴の趣旨

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人は、控訴人に対し、1億4200万円及びこれに対する平成26年3月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 3 訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人の負担とする。
- 4 仮執行宣言。

第2 事案の概要

1 事案の要旨

(1) 本件請求の要旨

本件は、控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人が製造、販売等をする被控訴人製品が、控訴人の有する①本件特許権1（特許第2932136号「電子部品の樹脂封止成形方法及び装置」、平成25年7月22日存続期間満了）及び本件特許権2（特許第2932137号「電子部品の樹脂封止成形方法及び装置」、平成25年7月22日存続期間満了）を侵害するとして、不法行為に基づいて、平成23年2月28日から平成25年7月22日までの間に控訴人に生じた損害金22億2600万円（特許法102条2項適用）の一部である1億円の支払と、②本件特許権1及び本件特許権2の実施料相当額の不当利得の返還請求権に基づいて、平成16年2月28日から平成23年2月27日までの間に被控訴人に生じた利得金10億7800万円の一部である4200万円の返還と、③上記①②の合計である1億4200万円に対する、不法行為後の日で、本件訴状送達により催告のされた日の翌日である平成26年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。

本件の請求原因事実に係る特許請求の範囲（分説後）は、次のとおりである。

- ① 本件発明1（本件特許1の請求項3）

【A-1】固定型と可動型とを対向配置した金型と，該金型に配設した樹脂材料供給用のポットと，該ポットに嵌装した樹脂加圧用のプランジャと，上記金型の型面に配設したキャビティと，該キャビティと上記ポットとの間に配設した樹脂通路とを有するモールドイングユニットと，

【A-2】上記モールドイングユニットに電子部品を装着した樹脂封止前リードフレーム及び樹脂タブレットを供給する手段と，

【A-3】樹脂封止された電子部品を上記モールドイングユニットから外部へ取り出す手段とを備えた電子部品の樹脂封止成形装置であって，

【B】既に備えられた上記モールドイングユニットに対して他のモールドイングユニットを着脱自在の状態に装設可能とし，これによって該モールドイングユニットの数を増減調整自在に構成したことを特徴とする

【C】電子部品の樹脂封止成形装置。

② 本件発明2（本件特許2の請求項3）

【D-1】固定型と可動型とを対向配置した金型と，該金型に配設した樹脂材料供給用のポットと，該ポットに嵌装した樹脂加圧用のプランジャと，上記金型の型面に配設したキャビティと，該キャビティと上記ポットとの間に配設した樹脂通路とを有するモールドイングユニットと，

【D-2】上記モールドイングユニットに電子部品を装着した樹脂封止前リードフレーム及び樹脂タブレットを供給する手段と，

【D-3】樹脂封止された電子部品を上記モールドイングユニットから外部へ取り出す手段とを備えた電子部品の樹脂封止成形装置であって，

【E】既に備えられた上記モールドイングユニットに対して相互に異なる種類の他の電子部品の樹脂封止成形用モールドイングユニットを着脱自在の状態に装設可能とし，これによって，相互に異なる少なくとも二種類以上の電子部品の樹脂封止成形用モールドイングユニットを構成したことを特徴とする

【F】電子部品の樹脂封止成形装置。

(2) 原審の判断

原判決は、被控訴人製品のうち、主として審理の対象とされたハ－3号製品（ハ号製品のうち、6枚取りとなっているもの）は、構成要件B、E（特に「着脱自在の状態に装設可能」の点）を充足せず、他の被控訴人製品もハ－3号製品と異なる構造ではないと認められるから、結局、被控訴人製品は、すべて構成要件B、Eを充足しないとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。

2 前提となる事実

本件の前提となる事実は、原判決の「事実及び理由」欄の第2（事案の概要等）の「2 前提事実等」に記載のとおりである。

3 争点

本件の争点は、原判決の「事実及び理由」欄の第2（事案の概要等）の「3 争点」に記載のとおりである。

第3 当事者の主張

当事者の主張は、下記のとおり、当審において追加提出されたハ－3号製品説明書（乙14）に基づく当事者の補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第3（争点に関する当事者の主張）に記載のとおりである。

（当事者の補充主張）

1 控訴人

(1) ガイドレールその他搬送レール機構について

長尺製品を用いると価格や輸送コストも高く製作に時間がかかることなどから、当業界においても短尺機械を連結することが基本となっており、被控訴人も、自社で用いられている工作機械の加工範囲が幅●●●cmまでであることを認めている。そうであれば、●●●●●●についても幅●●●cm以下の長さのものしか製作する

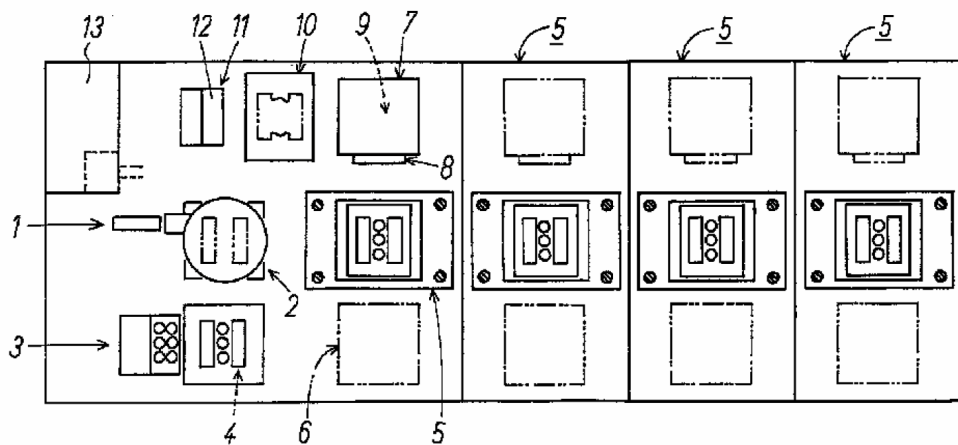
- ① 原判決 47 頁 7 行目の「配置」及び同 17 行目の「一体構造の」をいずれも削る。
- ② 原判決 49 頁 2 行目の「当業者にとっての」から同 11 行目末尾までを削り、同 22 行目の「全ユニット」を「ユニット間」に改める。
- ③ 原判決 50 頁 1 行目から 2 行目にかけての「全ユニット」を「ユニット間」に改める。

2 争点(2)イ (被控訴人製品が本件発明 1 の構成要件 B 及び本件発明 2 の構成要件 E を充足するか) について

(1) 本件明細書の記載

原判決 22 頁 1 行目から同 26 頁 4 行目までに記載のとおりである。ただし、本件明細書 1 (甲 2) の【図 4】(最小構成単位の樹脂封止成形装置に、他のモルディングユニットを複数単位追加して組み合わせた状態を示す概略平面図) 及び【図 7】(樹脂封止成形装置と他のモルディングユニットとの連結部及び各モルディングユニット間の連結部を示す概略平面図) を加える。

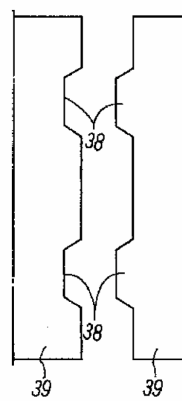
【図 4】



1 : 樹脂封止前リードフレーム供給ユニット 2 : リードフレーム整列ユニット

- 3 : 樹脂タブレット供給ユニット 4 : 樹脂タブレット搬出ユニット
 5 : モールドイングユニット 6 : ローダーユニット 7 : アンローダーユニット
 8 : クリーナーユニット 9 : 樹脂封止済リードフレーム搬送ユニット
 10 : ディゲーティングユニット 11 : ピックアップユニット
 12 : リードフレーム収容ユニット 13 : コントローラーユニット

【図7】



38 : 係合手段 39 : ボトムベース

(2) 控訴人製品について

控訴人が本件発明1の実施品と主張する控訴人製品(「オートモールドイングシステムY1E2060」)については、原判決28頁4行目から同31頁7行目までに記載のとおりである。ただし、原判決28頁13行目から同14行目にかけての「トルクで締め付ける」の前に「十分な」を、同29頁8行目の「ゴムバンドのはめ込み」の前に「ダクトの隙間への」を、同30頁5行目の「トルクで締め付けられている」の前に「十分な」をそれぞれ加える。

(3) 特許請求の範囲の解釈について

ア 「着脱自在の状態では装設可能」の技術的意義

上記(1)の本件明細書の記載によれば、本件発明は、①従来の樹脂封止成形装置においては、少量生産又は大量生産への対応を金型を選択することによって行われていたが、②大量生産用の大型金型については、加工精度を均一にすることの困難等

に伴う問題点があり，③異なる成形品を同時に成形することへの対応は，金型の交換，金型のレイアウトの変更，複数金型の同時装着によって行われていたが，交換作業や金型の設計製作が面倒であるなどの問題点があったことから，④最少構成単位の樹脂封止成形装置に，同じ又は他の製品用のモルディングユニットを適宜追加し，又は追加したモルディングユニットを適宜取り外す構成を採用することにより，必要な生産量や製品種類に簡易に対応し得るようにしたものであると認められる。

そして，本件発明1の構成要件Bは，「既に備えられた上記モルディングユニットに対して他のモルディングユニットを着脱自在の状態に装設可能とし」と規定し，この「既に備えられた上記モルディングユニット」が，樹脂封止前リードフレーム及び樹脂タブレット供給手段（構成要件A-2）と樹脂封止電子部品取出手段（構成要件A-3）を備えた樹脂封止成形装置の一部を構成していることは明らかであるから，「他のモルディングユニット」の装設は，このような樹脂封止成形装置の一部である状態のモルディングユニットに対して着脱するものであっても，その着脱が「自在」にされ得るものであると認められる。

このような，モルディングユニットの追加又は取外しによる生産の効率化という本件発明の目的や，既設のモルディングユニットに対しても着脱を自在にするという構成要件の内容に照らすと，本件発明1の構成要件Bの「着脱自在の状態に装設可能」とは，①単に，複数のプレス設置ユニットを有するモジュール形式の半導体樹脂封止装置というだけの場合と，②各モジュールが他のモジュールとの間で物理的には着脱が可能であるもののその着脱が想定されていない構造である場合の，いずれをも含むものではなく，③プレス設置ユニットを有するモジュールがその着脱に適した構造を有している場合をいうものと解するのが相当である。

以上は，本件発明2の構成要件Eの「着脱自在の状態に装設可能」についても，同様であると解される。

したがって，控訴人の主張の趣旨が，「着脱自在の状態に装設可能」とは，モー

ルディングユニットの着脱が金型の交換又は装置全体を交換することに比して容易であれば足りるというものとすれば、上記のところからみて、その主張を採用することはできない。

イ 着脱自在のための技術的手段

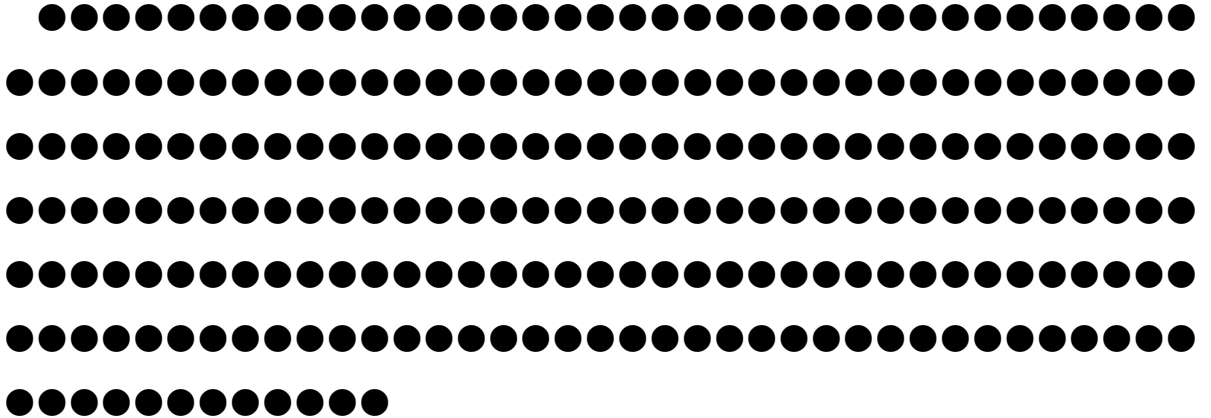
被控訴人は、「着脱自在」といえるためには、それぞれのモールドディングユニットが、その各接続部においては実施例に記載されたような係合手段を用いるのと同様の容易さで着脱でき、かつ、着脱のために容易に移動することができ、また、その容易さの程度は、生産現場における装置の使用者にとっても容易なものといえなければならないと主張する。

しかしながら、本件明細書(甲2, 4)には、「着脱自在」の態様を具体的に限定する記載はなく、実施例として、ベース部に設けられた凸部と凹部から構成される係合手段を用いて位置決めをすること(本件明細書1【0015】【0035】【図7】、本件明細書2【0014】【0034】【図7】)と、最少構成単位の組合せからなる環状に構成された樹脂成形装置に、この各装置を移動することなく追加のモールドディングユニットを脇から順次継ぎ足していき、最少構成単位の構成部材を兼用するという装置の配置方法(本件明細書1【0031】～【0034】、本件明細書2【0030】～【0033】)が例示されているだけと認められる。

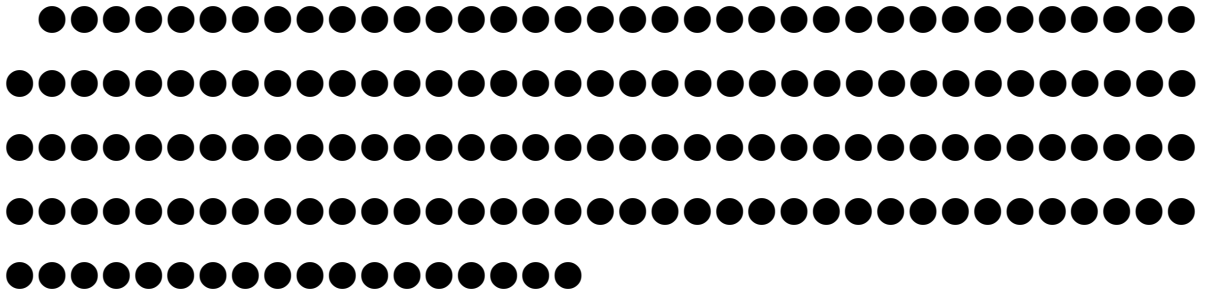
したがって、着脱自在のための技術的手段が、特定の技術的手段に限定されているとはいえない。そして、このように解しても、一般に、機械分野においては、部品同士又はユニット同士を着脱自在とする構成について従来から様々な手段が知られているから、当業者であれば、技術常識として従来から知られている手段を採用することで、モールドディングユニットと他のモールドディングユニットとを着脱自在に装設できるものと認められる。また、本件発明は、モールドディングユニットの増減設を行った場合に、追加されたモールドディングユニットが装置として一体となって樹脂封止成形を行うことを当然の前提としているから、着脱の内容としては、追加されたモールドディングユニットと既存のモールドディングユニットとのフレームを



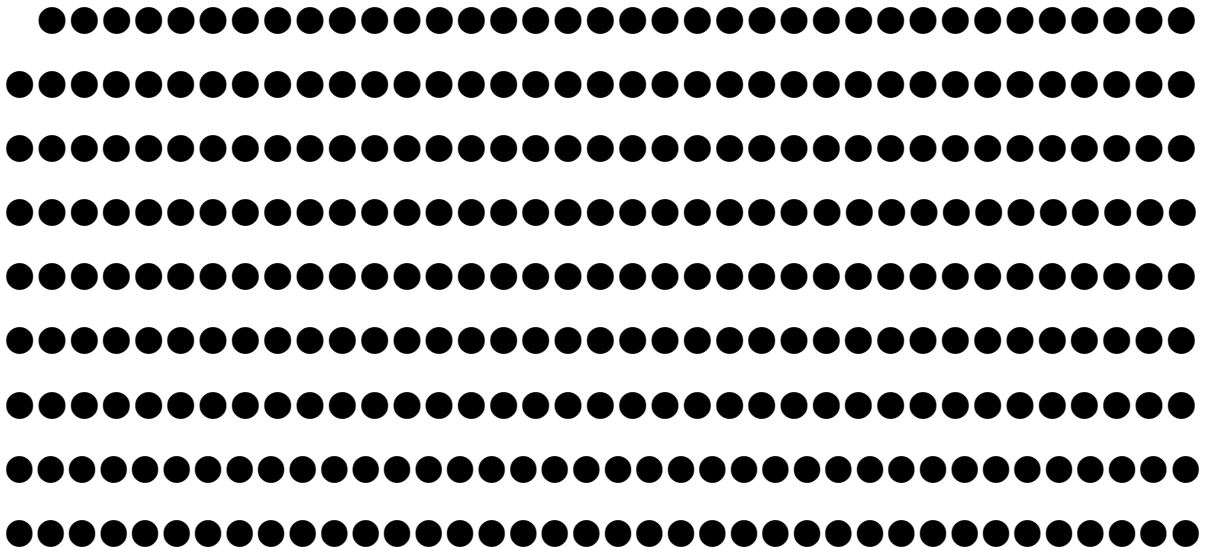
③ 搬送レール機構



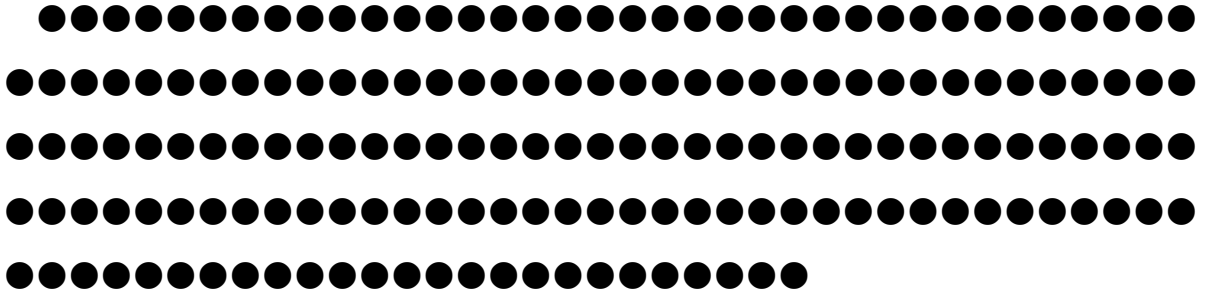
④ 電気配線



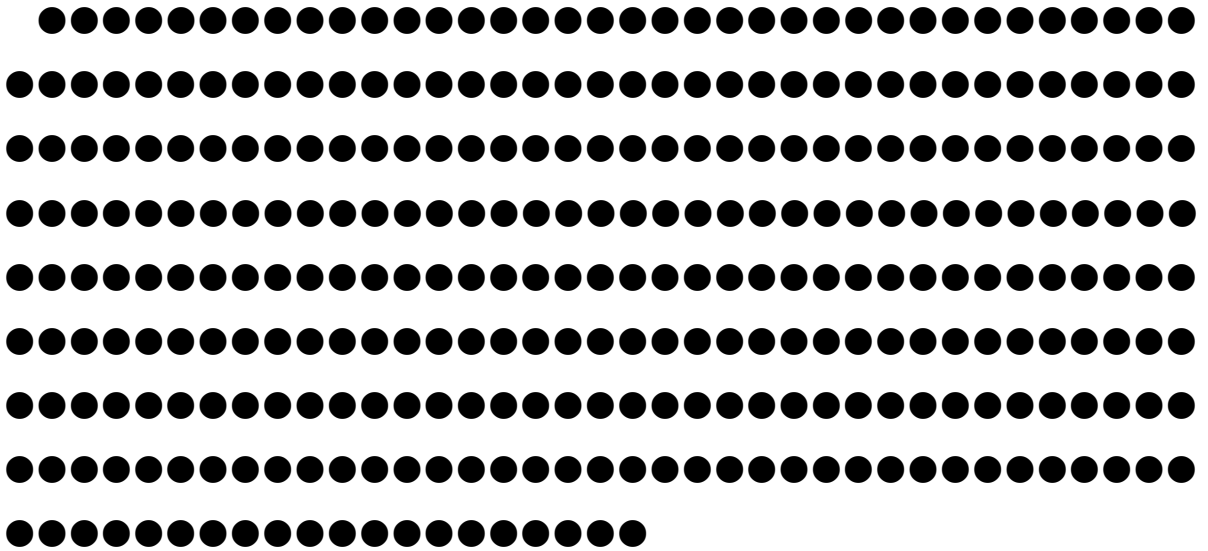
⑤ 圧縮エアチューブ



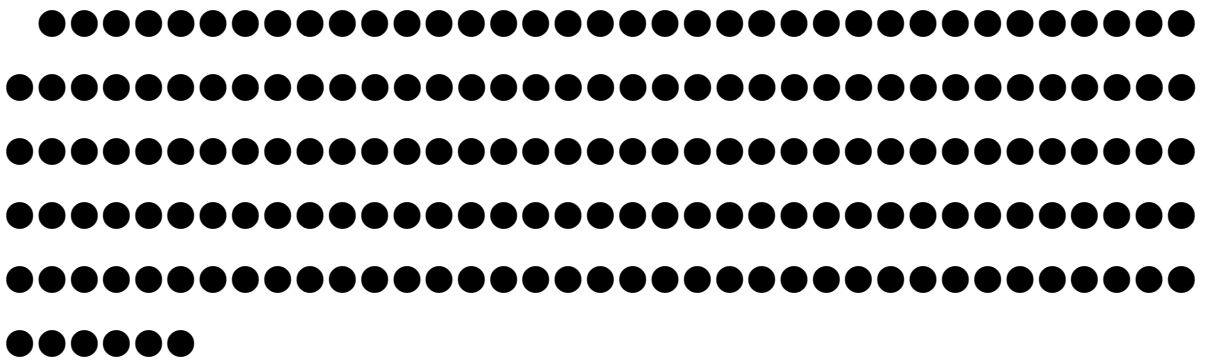
⑥ 油圧ホース



⑦ バキュームダクトホース



⑧ 信号線



イ 検討

上記認定によると、ハー3号製品において、●●●●●●●●●●●●●●●●を取り外すこと又はプレス設置ユニットを追加することは、技術的に不可能ではなく、また、その取外し又は追加の費用は、経済的に過分とまではいえないと推認される。しか

